



产品特点

- 脱醇型单组分室温固化有机硅粘接密封胶
- 优异绝缘、防潮、抗震、耐电晕、抗漏电和耐化学介质等性能
- 对大多数金属和非金属材料具有良好密封、粘接性
- 完全符合欧盟ROHS、REACH等指令要求

典型应用

- 传感器、IC集成模块、散热器、工业及家居电器设备、灯具等产品的导热、防水、防潮、粘接
- PCB敏感元件、电容、三极管 电感等电子元器件固定及粘接。也可以用于引脚的涂覆保护
- 有粘接要求的金属、塑胶、玻璃及工程塑料等

使用说明

1. 清洁表面: 将被粘或被涂覆物表面整理干净, 除去锈迹, 灰尘和油污等。
2. 施胶: 削开前部尖端口, 套上尖嘴, 利用专业点胶机或人工打胶器将电子粘结剂施胶在需要黏合的电子、电器部件位置上, 一般要均匀涂抹。根据产品说明书进行静置固化, 以保证黏合效果。
3. 操作完成后, 未用完的胶应立即拧紧盖帽, 密封保存。

技术参数

项目	参考标准	KY-HCG3066W	KY-HCG3066B	KY-HCG3066GY
颜色	目测	白色	黑色	灰色
状态	目测	半流淌		
相对密度 (g/cm ³)	GB/T533-2008	1.4±0.1		
表干时间 (min)	GB/T13477.5-2002	≤10		
硬度 (shore A)	GB/T531.1-2008	40±5		
断裂伸长率 (%)	GB/T528-2009	≥150		
剪切强度 (MPa)	GB/T7124-2008	≥2.0		
抗拉强度 (Mpa)	GB/T528-2009	≥2.0		
体积电阻率 (Ω · cm)	GB/T1692-2008	≥1.0×10 ¹⁵		
绝缘击穿强度 (Kv/mm)	GB/T1695-2005	≥20		
介电常数 (100MHz)	GB/T1697-2003	4.5		
温度范围 (°C)	使用环境实测	-60~200		

注: 以上性能数据均在25℃, 相对湿度55%成型1天后所测, 本公司对测试条件不同或产品改进造成的数据不同不承担相关责任, 图像可能不同于原产品。

注意事项

1. 操作完成后, 余胶需密封保存, 避免胶体固化。再次使用时, 除去封口处少许结皮后再使用。
2. 不慎接触皮肤, 擦拭干净, 然后用清水冲洗; 若不慎接触眼睛, 立即用清水冲洗并到医院检查。安全性资料请参阅产品的MSDS。

贮存要求

1. 本产品为无毒非危险品, 按一般化学品搬运和运输即可。使用后注意密封, 储存于阴凉、干燥、通风处。
2. 本产品需在温度5℃-38℃、湿度35%-75%RH环境中贮存, 贮存期为6个月。

包装规格

- 100ML/支 100支/箱;
300ML/支, 25支/箱;
2.6L/支, 4支/箱;
可根据客户要求定制。

特别说明

本说明书的数据是实验室条件下获得, 由于使用环境的差异, 使用者要参照这些数据和使用条件进行分析和试验。跨越电子不承担销售产品和特定工况下使用跨越电子产品出现的问题, 不承担任何直接, 间接或意外损失责任。用户在使用过程遇到什么问题, 可以和跨越电子技术服务部门联系, 我们将为您提供一切帮助。